

2016 年培训课程计划

序号	课程名称	授课专家	时间	地点
1	高级堆叠封装集成	John Xie	3.17-19	无锡
2	集成电路前沿和发展趋势：纳米技术的最新进展和应用	Marc Heyns Liesbet Van der Perre	3.21-23	北京
3	超低功耗智能可穿戴人体传感器节点和物联网演化	David Atienza	4.18-20	深圳
4	高级数字 IC 设计技术——综合和优化	Giovanni De Micheli	5.9-11	南京
5	CMOS 毫米波电路设计	Patrick Reynaert	5.17-19	成都
6	密码学与密码协议：攻击与对策	Svetla Nikova Vincent Rijmen	5.23-25	深圳
7	高级超大规模集成电路存储器设计和集成	PE.Gaillardon	6.1-3	武汉
8	半导体缺陷：起源，表征和对器件工艺的影响	Cor Claeys	6.13-14	上海
9	FinFET——从基本概念到未来趋势	Chenming Hu	6.28	上海
10	超大规模集成电路互连架构和建模	Azad Naeemi	7.11-13	合肥
11	低压低功耗 IC 设计的 MOS 晶体管建模和 BSIM6 参数提取	Christian Enz	8.22-24	深圳
12	万物互联(IoE)的最新技术与应用	Thomas Lee	8.26-27	上海
13	嵌入式多核硬软件系统的高级设计方法和工具	Rainer Leupers	9.5-7	北京
14	数字集成电路测试和可测性设计	Erik Jan Marinissen	9.19-21	杭州
15	CMOS 纳米技术的可靠性、低频噪声和早期评估	Felice Crupi	10.24-26	北京
16	CMOS 中的 AD 和 DA 转换器设计	Michiel Steyaert	10.31-11.2	上海

工业和信息化部人才交流中心：

电 话：010-68207879、68207883

传 真：010-68207863

E-mail：icplatform@miitec.cn